

Memorandum of Understanding  
for the Strategic Cooperation  
between  
National Scientific Research Institute on Semiconductors  
and Microelectronics  
under the National University of Uzbekistan  
and  
Uzbek-Japan innovation Center of Youth  
under the Tashkent state technical university  
named after Islam Karimov

---

Меморандум о Взаимопонимании  
между  
Научно-исследовательским институтом физики  
полупроводников и микроэлектроники при  
Национальном университете Республики Узбекистан  
и  
Узбекско-Японским молодежным центром инноваций  
при Ташкентском государственном техническом  
университете имени Ислама Каримова

С.С.

Sh. Ulamurodova



**This Memorandum of Understanding** (the "MOU"), is hereby established by and between National Scientific Research Institute of Semiconductors and microelectronics under the National University of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as "NSRISM"), represented by Director Dr. Sharifa Utamuradova Bekmuradovna and Uzbek-Japan Innovation Center of Youth (hereinafter referred to as "UJICY") represented by Director Mr. Saidmurod Niyazbekov Saidrasulovich are referred to collectively, as "Parties" or individually as "Party". This MOU is not legally binding and any obligation or commitment of funding for Projects or as otherwise contemplated by this MOU will be affected through separate agreements between the Parties and/or potential funding recipients.

**WHEREAS**, the Parties see great potential in a close partnership and wish to coordinate and leverage their respective financial, human, technical and other resources in scientific and technological cooperation for the purpose of accelerating, initially, the discovery, development, delivery and commercialization, when appropriate, of innovative technologies that could generate income for both Sides and considering, in future, undertaking similar R&D activities;

**WHEREAS**, the Parties herein desire to enter into a MOU setting forth the realization of collaborative projects; and

**NOW, THEREFORE**, the Parties decide that this MOU sets forth certain mutual understandings and guiding principles for their strategic cooperation.

Настоящий Меморандум о **Взаимопонимании** (далее "Меморандум"), заключается между Научно-Исследовательским институтом физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном Университете Республики Узбекистан (далее – НИИ физики полупроводников и микроэлектроники) в лице директора Утамурадовой Ш.Б. и "Узбекско-Японским молодежным центром инноваций" при Ташкентском государственном техническом университете имени Ислама Каримова (далее – УЯМЦИ) в лице директора Ниязбекова С.С совместно именующиеся, как «Стороны» или в отдельности «Сторона». Меморандум не является юридическим обязательством, и любые договоренности или обязательства по осуществлению совместных проектов, будут рассматриваться в рамках отдельных соглашений между сторонами и/или потенциальными получателями финансирования.

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ**, что Стороны осознают значительный потенциал тесного сотрудничества и выражают заинтересованность в координации использования соответствующих финансовых, человеческих, технических и иных ресурсов в научно-техническом сотрудничестве с целью ускорения научных разработок и коммерциализации инновационных технологий.

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ**, что Стороны изъявляют желание реализовывать совместные проекты.

**ТАКИМ ОБРАЗОМ**, Стороны решили, что настоящий Меморандум устанавливает взаимные договоренности и руководящие принципы для стратегического сотрудничества.

С.С.

Sh. U.



## 1. PURPOSE

1.1. The Parties recognize the benefits to be derived from increased collaboration, cooperation and interaction in general.

The purpose of this MOU is to define a collaborative framework between Parties in the area of collaboration, cooperation and interaction, which create synergy to both Parties.

The purpose of this MOU is to identify fields of research in which the Parties are willing to work together for mutual benefit, as well as establish a framework for cooperation between the Parties.

## 2. SCOPE

This MOU sets forth the intentions of the Parties for increased collaboration, cooperation and interaction and does not create any legally binding commitments. If the Parties later agree to undertake specific joint projects with legally binding obligations, they will develop separate written agreements for such projects, setting out each Party's contributions, deliverables, and budgets.

### The Parties agreed that:

2.1. To support and consult each other in the process of development and realization of the projects (in particular, those on semiconductors and microelectronics).

2.2. To develop and realize the projects on semiconductors and microelectronics with participation of international experts.

2.3. To provide necessary information about the projects and their implementation, including promotion of projects, assessment and determination of conditions for their profitable realization.

2.4. The Parties shall promote collaboration on commercialization of technology through Start-up Program and joint hosting of seminars and conferences in Uzbekistan.

## 1. ЦЕЛЬ

1.1. Стороны осознают пользу, извлекаемую от укрепления сотрудничества и взаимодействия в целом.

Цель настоящего Меморандума заключается о взаимопонимании в определении рамок сотрудничества между Сторонами в тех областях взаимодействия, которые создают синергизм для обеих Сторон.

Целью настоящего Меморандума является определение направлений исследований, в которых Стороны изъявляют желание совместно работать для получения взаимной выгоды, а также установление рамок сотрудничества между Сторонами.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Меморандум о взаимопонимании устанавливает намерения сторон в сфере расширения сотрудничества и научного взаимодействия и не создает никаких юридических обязательств. В случае если Стороны намереваются осуществлять конкретные совместные проекты с юридическими обязательствами, будут подписаны отдельные соглашения с определением вклада каждой Стороны, конечного результата деятельности, и бюджета проектов.

### Стороны намерены:

2.1. Поддерживать и консультировать в процессе разработки и реализации проектов (в частности, проектов по физике полупроводников и микроэлектроники).

2.2. Разрабатывать и реализовывать проекты по физике полупроводников и микроэлектроники с участием иностранных экспертов.

2.3. Предоставлять необходимую информацию о проектах и их реализации, включая продвижение проектов, оценку и определение условий для выгодной их реализации.

2.4. Стороны будут содействовать сотрудничеству в области коммерциализации технологий посредством Программы стартапов

CC

Sh. R.



**2.5.** The Parties shall seek possibilities of joint scientific researches activities in the fields and subjects where synergy of cooperation will be expected for the Parties. The fields and subjects of joint researches shall be conducted under the separate individual MOU.

### **3. COSTS**

**3.1.** Each Party will be responsible for its own costs in connection with all matters relating to collaborations under this MOU. Where possible and appropriate, the Parties may also seek funding jointly for collaborations from other sources

### **4. GENERAL PROVISION**

**4.2.** The consideration of intellectual property rights developed through cooperation within the framework of this MOU will be determined between the Parties through mutual consultations and separate written agreements on a case-by-case basis on an individual basis.

### **5. CONFIDENTIALITY**

**5.1.** The Parties agree that there is no intention to share any confidential or proprietary information in any collaboration under this MOU. Neither Party discloses confidential information to the third parties without the prior written consent of the other Party.

### **6. DURATION**

**6.1.** This MOU will come into force from the date of its signing and is valid within one year with automatic prolongation for similar further periods until any of the Parties notify the other Party about intention to terminate the force of this MOU sixty days prior before the expiration of corresponding period.

и совместного проведения семинаров и конференций в Узбекистане.

**2.5.** Стороны будут искать возможности для совместной деятельности в области научных исследований в областях и темах, где ожидаются взаимодействие между Сторонами. Области и предметы совместных исследований проводятся в рамках отдельного индивидуального меморандума.

### **3. РАСХОДЫ**

**3.1.** Каждая Сторона будет нести ответственность за собственные расходы в связи со всеми вопросами, связанными с сотрудничеством, рамках настоящего Меморандума. При возможности Стороны могут также совместно получать финансирование из других источников

### **4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**4.2** Учет прав интеллектуальной собственности, разработанной посредством сотрудничества рамках настоящего Меморандума, будет определяться между Сторонами путем взаимных консультаций и отдельных письменных соглашений о каждом конкретном случае на индивидуальной основе.

### **5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**5.1.** Стороны осознают, что отсутствует намерение делиться конфиденциальной или служебной информацией в рамках настоящего Меморандума. Ни одна из сторон не раскрывает конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

### **6. СРОК**

**6.1.** Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с автоматической пролонгацией на аналогичный период. Если любая из Сторон намеревается прекратить действие Меморандума, Сторона должна уведомить другую Сторону за шестьдесят дней до истечения действия Меморандума к соответствующему периоду.

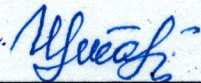
С. С.

Sh. U.



**SIGNED BY:**

**Sharifa Utamuradova Bekmuradovna**



Director of the National Scientific Research Institute of Semiconductors and microelectronics  
under the National University of the Republic of Uzbekistan.

Date 15.05.2023 y

**Saidmurod Niyazbekov Saidrasulovich**



Director of the Uzbek-Japan innovation center of youth under the Tashkent state technical  
university named after Islam Karimov.

Date 16.05.2023.

*C.C.*

*Sh. U.*